

10月市场洞察报告

半导体市场分析与趋势展望

“DISTINCTIVE
INSIGHTS,
INFORMED
DECISION-MAKING”

洞察行情 精准决策

序言

本报告由安芯易电子商务（深圳）有限公司推出，旨在为客户、供应商及合作伙伴提供半导体行业资讯及市场趋势预测，报告涵盖宏观动态、半导体产业动态、终端市场动态、重点产品行情等模块，助力行情洞察、精准决策。

本报告每月更新，可关注安芯易电子微信公众号，及时获取报告发布等信息。您也可以通过联系安芯易客户经理获取完整版报告。

目录

摘要..... 4

一、宏观动态..... 5

 (一) 行业政策..... 5

 (二) 经济指数..... 8

二、半导体产业动态..... 13

 (一) 短期影响..... 14

 (二) 中期影响..... 18

 (三) 长期影响..... 20

三、终端市场动态..... 23

 (一) 人工智能..... 24

 (二) 新能源..... 25

 (三) 消费电子..... 25

 (四) 工业电子..... 26

 (五) 汽车电子..... 26

 (六) 通信电子..... 27

 (七) 医疗电子..... 27

四、重点产品行情..... 28

 (一) 存储芯片..... 28

 (二) GPU..... 30

 (三) CPU..... 31

信息来源..... 33

免责声明..... 38

摘要

2025 年 10 月重点行情趋势	
宏观动态	● 美国/中国：两国领导人在釜山会面，就关税、稀土、英伟达等问题进行磋商 ● 荷兰：荷兰政府对安世半导体实施国家安全干预，强化对关键制造环节的控制 ● 英国：制裁措施引发中方强烈反应，科技贸易摩擦再度升级 ● 日本：高市早苗新内阁启动 13 万亿日元刺激计划，聚焦半导体与 AI 产业 ● 美国/沙特阿拉伯：半导体对话推进，寻求合作机会 ● 美国/马来西亚：签署互惠贸易协定，将马半导体供应链纳入美“适当考虑”范畴
产业动态	● 短期影响：安世半导体：供应链中断冲击全球汽车产业，多家车企面临停产压力；英伟达：市值突破 5 万亿美元里程碑，彰显 AI 算力龙头地位；美光/三星/SK 海力士：存储芯片供需错配，价格进入上行周期；三星电子：存储市场复苏强劲，短期业绩显著改善；美光：AI 驱动存储需求，短期业绩与股价双丰收；恩智浦：车用芯片需求初现回暖，Q3 财报略超市场预期；博通：发布新网络芯片 Thor Ultra，强化 AI 数据中心布局；意法半导体：公布 Q3 财报，汽车半导体需求持续低迷；SK 海力士：Q3 业绩创纪录增长，HBM 供应锁定确保短期领先地位；兆易创新：存储行业景气回升，短期业绩大幅增长。 ● 中期影响：英伟达：全栈 AI 战略协同推进，中期构建完整技术生态系统；亚德诺：“轻封测化”战略转型，优化中期资本配置；英飞凌：SiC 封装合作，构建中期供应链韧性；微芯科技：首发 3nm PCIe 6.0 交换机，破解 AI 数据中心互联瓶颈；SK 海力士：推出“A1N Family”面向 AI 存储产品；中微半导：营收增长但利润承压，中期转型面临挑战。 ● 长期影响：赛微电子：出售 Silex 控股权实现短期盈利，长期发展面临挑战；长鑫存储：拟 2026 年科创板 IPO，估值战略意义重大；日月光：巨资投入先进封装，应对 AI 芯片长期需求；国巨电子：收购芝浦电子，完善高端元件长期布局；Skyworks & Qorvo：巨头合并重塑射频芯片市场长期格局。
终端市场	● 人工智能：OpenAI 与博通合作定制 AI 芯片；英伟达 AI 芯片 Blackwell (GPU) 现已在美国全面投入生产；高通发布两款数据中心级人工智能推理芯片；英特尔推出新一代数据中心 GPU。 ● 新能源：宁德时代正推进钠新乘用车动力电池开发；比亚迪马来西亚工厂将于 2026 年投产。 ● 消费电子：荣耀发布旗舰新品 Magic8 系列；vivo 上海发布 X300 系列旗舰智能手机；阿里云与英伟达官宣合作 Physical AI，押宝具身智能、辅助驾驶。

	● 工业电子：施耐德携手宏于推 Okken 授权配电盘，驱动电力基础设施升级；罗克韦尔发布 FactoryTalk Design Workbench 免费设计软件。 ● 汽车电子：受安世供应影响，汽车制造商四处搜寻芯片；英伟达发布集软硬件一体化的 Hyperion 10 自动驾驶平台。 ● 通信电子：中兴通讯蝉联中国云终端市场第一；英伟达宣布斥资 10 亿美元入股芬兰电信设备商诺基亚。 ● 医疗电子：联影医疗与印度 Super health 签署 20 亿放射影像设备采购合同。
产品行情	● 存储芯片：现货 NAND、DRAM 资源全面供应趋紧，存储价格集体强势上涨 ● GPU：AI 需求致高端 GPU 货源紧缺，价格进一步上涨 ● CPU：AI 成为绝对主导，驱动全产业链需求

一、宏观动态

（一）行业政策

● 美国/中国：两国领导人在釜山会面，就关税、稀土、英伟达等问题进行磋商

2025 年 10 月 30 日，中美领导人在 APEC 峰会期间达成贸易框架协议。根据协议，美国将对华平均关税从 57%下调至 47%，并暂停原定 11 月实施的 100%额外关税；中方则同意暂停稀土出口管制至少一年。在半导体领域，美方允许英伟达就特定型号 AI 芯片开展对华销售磋商，但仍将最先进的 Blackwell 架构芯片排除在外。

此次协议为半导体产业带来三重利好：关税下调降低芯片贸易成本；稀土供应稳定保障关键原材料安全；AI 芯片对话窗口为技术贸易注入积极预期。不过，英伟达对华销售的具体型号、数量及许可机制等关键细节仍有待明确，实际供应链改善程度仍取决于后续细则的落地。半导体产业在把握短期缓和机遇的同时，仍需对中长期地缘政治风险保持警惕。

● 荷兰：荷兰政府对安世半导体实施国家安全干预，强化对关键制造环节的控制

2025 年 10 月 12 日，荷兰政府依据《货物可用性法》（Goods Availability Act）对荷兰半导体公司安世半导体（Nexperia）实施干预，理由是公司存在“严重治理缺陷”，可能危及荷兰及欧洲在关键半导体技术与制造能力上的安全。

此次干预导致安世半导体的母公司闻泰科技（Wingtech）在上海股市的市值下跌约 10%。荷兰政

府强调，安世半导体的运营可继续进行，但若其决策被视为有害，政府有权予以阻止。该事件反映出欧美在半导体产业链中的技术主权争夺愈发激烈。

中国政府随后对安世半导体实施出口管制，禁止其及其分包商出口特定成品元器件和组件。这一举措对欧洲汽车产业造成了严重影响，德国大众汽车集团已宣布暂停沃尔夫斯堡工厂的高尔夫 (Golf) 车型生产，并可能波及其他车型。

安世半导体临时首席执行官 Stefan Tilger 警告称，强烈建议客户不要接收或使用来自中国工厂生产的芯片，理由是这些芯片可能不符合质量标准。对此，中国安世方面发布声明，坚决反对荷兰安世的指控，强调其产品完全符合技术标准和质量要求，并承诺保障客户供应链稳定。

此次事件不仅揭示了全球半导体产业链的脆弱性，也凸显了国家安全、技术主权与全球供应链之间的复杂关系。在全球科技竞争与地缘风险加剧的背景下，半导体产业已成为各国产业政策与贸易政策交叉的重要战场。

● 英国：制裁措施引发中方强烈反应，科技贸易摩擦再度升级

2025 年 10 月 15 日，英国外交、联邦及发展办公室 (FCDO) 更新了《英国制裁名单》(UK Sanctions List)，将包括易准科技、宏芯微科技 (香港) 和伊奇信电子科技有限公司在内的 11 家中国科技实体列入制裁对象，实施资产冻结及信托服务限制。英方称这些企业涉嫌向俄罗斯能源及军工行业提供关键物项。

对此，中国商务部于 10 月 27 日晚通过官方网站发布新闻发言人答记者问，表达了严正立场。中方指出，英方以涉俄为由单方面列单中国企业，缺乏国际法依据与联合国授权，属于典型的单边制裁行为。发言人强调，中国政府一贯依法依规严格管控军民两用物项出口，中俄企业的正常经贸往来不应受到干扰或政治化干预。

商务部表示，英方此举不顾中方多次交涉与两国经贸关系良好发展的势头，坚持采取制裁措施，势必对中英双边经贸合作产生负面影响。中方敦促英方从维护中英经贸合作大局出发，立即纠正错误做法，撤销对相关中国企业的制裁，并强调将坚定维护中国企业的正当合法权益。

分析人士指出，此次制裁事件标志着中英在科技与出口管制领域的政策摩擦进一步加深。鉴于半导体产业链的全球化特征，相关措施可能在短期内加剧供应链不确定性，扰动中小型电子元件分销商的国际业务活动，并对区域科技贸易环境造成新的压力。

● 日本：高市早苗新内阁启动 13 万亿日元刺激计划，聚焦半导体与 AI 产业

2025 年 10 月 21 日，高市早苗正式就任日本首相，并随即提出一项规模超过 13 万亿日元（约合

US\$92 亿) 的经济刺激方案, 将人工智能与半导体等战略性技术领域列为三大核心支柱之一。政府同时重组经济政策架构, 废除“实现新资本主义会议”, 新设“日本增长战略会议”, 标志政策重心由“增长与分配并重”转向“危机管理投资+产业强化”。在国际维度, 10 月 26 日日本与东盟国家(包括越南) 共同举办“越日半导体研讨会”, 旨在深化区域内半导体合作与供应链韧性建设。该系列政策表明日本正加速将半导体产业置于国家经济安全战略的核心位置: 短期来看, 将大规模引导企业投入日本本土或战略合作区域; 长期来看, 将推动日系半导体产业链从被动参与转向战略主导, 提升在全球供应链中的话语权。

● 美国/沙特阿拉伯: 半导体对话推进, 寻求合作机会

2025 年 10 月, 英特尔公司首席执行官陈立武(亦译谭立布) 与沙特阿拉伯通信与信息技术部长阿卜杜拉·阿尔-斯瓦赫举行会晤, 双方探讨了在半导体及人工智能领域的潜在合作。此次合作讨论符合沙特“2030 愿景”推动经济多元化、发展先进技术的战略目标。与此同时, 美国与沙特政府层面在半导体出口协议上也取得进展, 双方接近达成一项允许美国芯片制造商向沙特出口用于 AI 数据中心的高性能芯片的协议。这一系列动态反映了全球半导体产业合作正呈现多元化趋势, 中东资本积极融入全球科技产业链。

● 美国/马来西亚: 签署互惠贸易协定, 将马半导体供应链纳入美“适当考虑”范畴

2025 年 10 月 26 日, 吉隆坡举行的第 47 届东盟峰会期间, Donald Trump 代表美国与马来西亚正式签署了具有里程碑意义的《互惠贸易协定》。协议核心包括: 美国将为约 1711 项马来西亚出口商品(涵盖棕榈油、橡胶、可可、航空航天部件、药品等) 提供零关税待遇, 年出口价值约 52 亿美元, 占马来西亚对美出口总额约 12%。作为交换, 马来西亚承诺为美国的工业品(如化学品、机械设备、金属、乘用车) 及农产品(如乳制品、家禽、大米等) 提供显著市场准入。虽然半导体产品未被直接纳入此零关税清单, 但协议中明确指出, 美国将在依据《1962 年贸易扩展法》第 232 条对半导体产品做关税决策时, 将把马来西亚在此协议中作出的承诺纳入“适当考虑”范畴。此举为马来西亚在全球半导体封装与测试环节中的枢纽地位提供了额外保障, 同时也强化其作为“可信赖供应链基地”的战略角色。短期来看, 该协议有助降低马方出口障碍、提升投资信心; 长期则可能促进其半导体产业链在印太区域的深化与扩张, 并为美国推进“友岸化”供应链战略提供实质支撑。

(二) 经济指数

● 9 月全球制造业 PMI 微幅回调至 50.8，区域复苏步伐显著分化

2025 年 9 月，由摩根大通与标普全球联合编制的全球制造业采购经理人指数（PMI）录得 50.8，较 8 月的 50.9 微降 0.1 个百分点。尽管略有回调，该指数仍连续两个月站稳荣枯线之上，且创下自 2024 年 6 月以来的最佳连续表现，标志着全球制造业正处于疫情后相对稳健的复苏阶段。

从区域表现看，复苏态势呈现显著不均衡性：

- **亚洲主要经济体普遍改善：**中国制造业 PMI 回升至 51.2，自今年 3 月以来首次重返扩张区间；日本 PMI 达 51.1，结束连续 14 个月的收缩态势；韩国 PMI 报 50.7，实现温和扩张。
- **北美表现强劲：**美国制造业 PMI 升至 52.0，创 16 个月新高，新订单与生产指数双双改善。
- **新兴市场保持活力：**印度制造业 PMI 虽从 59.3 回落至 57.7，但仍维持强劲扩张势头。
- **欧洲成为主要拖累：**欧元区制造业 PMI 回落至 49.8，再度跌入收缩区间，显示该地区制造业复苏动能不足。

值得关注的是，尽管全球制造业产出已实现过去四个月中的第三次增长，新订单也保持温和增势，但整体复苏力度仍显疲弱。更为严峻的是，全球制造业就业水平在 9 月出现边际下滑，未完成业务量则连续第 39 个月下降，表明全球制造业整体产能过剩的局面尚未根本改善，需求端支撑仍不稳固。

这种区域分化的复苏格局对半导体产业需求产生直接影响：北美与亚洲部分经济体的持续回暖有望提振消费电子与汽车芯片需求，而欧洲市场的疲软则可能延缓工业半导体需求的全面复苏。企业需密切关注各区域 PMI 走势，精准把握不同市场的需求变化节奏。

全球各地区制造业 PMI

时间	全球	中国	日本	韩国	印度	美国	欧元区
2023-11	49.30	49.40	48.30	50.00	56.00	46.70	44.20
2023-12	49.00	49.00	47.90	49.90	54.90	47.40	44.40
2024-01	50.00	49.20	48.00	51.20	56.50	49.10	46.60
2024-02	50.30	49.10	47.20	50.70	56.90	47.80	46.50
2024-03	50.60	50.80	48.20	49.80	59.10	50.30	46.10
2024-04	50.30	50.40	49.60	49.40	58.80	49.20	45.70
2024-05	50.90	49.50	50.40	51.60	57.50	48.70	47.30

2024-06	49.50	49.50	50.00	52.00	58.30	51.70	45.60
2024-07	49.80	49.40	49.10	51.40	58.10	46.80	45.80
2024-08	48.90	49.10	49.80	51.90	57.50	47.20	45.60
2024-09	48.80	49.80	49.70	48.30	56.50	47.20	45.00
2024-10	48.80	50.10	49.80	48.30	57.50	46.50	46.00
2024-11	50.00	50.30	49.00	50.60	56.50	48.40	45.20
2024-12	49.60	50.10	49.60	49.00	56.40	49.20	45.10
2025-1	50.10	49.10	48.70	50.30	57.70	50.90	46.60
2025-2	50.60	50.20	49.00	49.90	56.30	50.30	47.60
2025-3	50.30	50.50	48.40	49.10	58.10	49.00	48.60
2025-4	49.80	49.00	48.70	47.50	58.20	48.70	49.00
2025-5	49.60	49.50	49.40	47.70	57.60	48.50	49.50
2025-6	50.30	49.70	50.10	48.70	58.40	49.00	50.50
2025-7	49.70	49.30	49.90	48.00	59.20	48.00	49.80
2025-8	50.90	50.50	52.00	48.30	59.30	53.00	50.70
2025-9	50.80	51.20	51.10	50.70	57.70	52.00	49.80

数据来源：Wind

● 2025 年 8 月全球半导体销售额增长 21.7%，亚太及美洲地区表现突出

2025 年 8 月，全球半导体销售额达 64.9 亿美元，同比增长 21.7%，较 2024 年 8 月的 53.3 亿美元增长显著，同时环比增长 4.4%，较 2025 年 7 月的 62.1 亿美元有所增加。根据全球半导体贸易统计组织（WSTS）提供的数据，这一增长主要受到亚太地区 and 美洲市场强劲需求的推动，其中记忆体和逻辑芯片的销售增幅尤为显著。

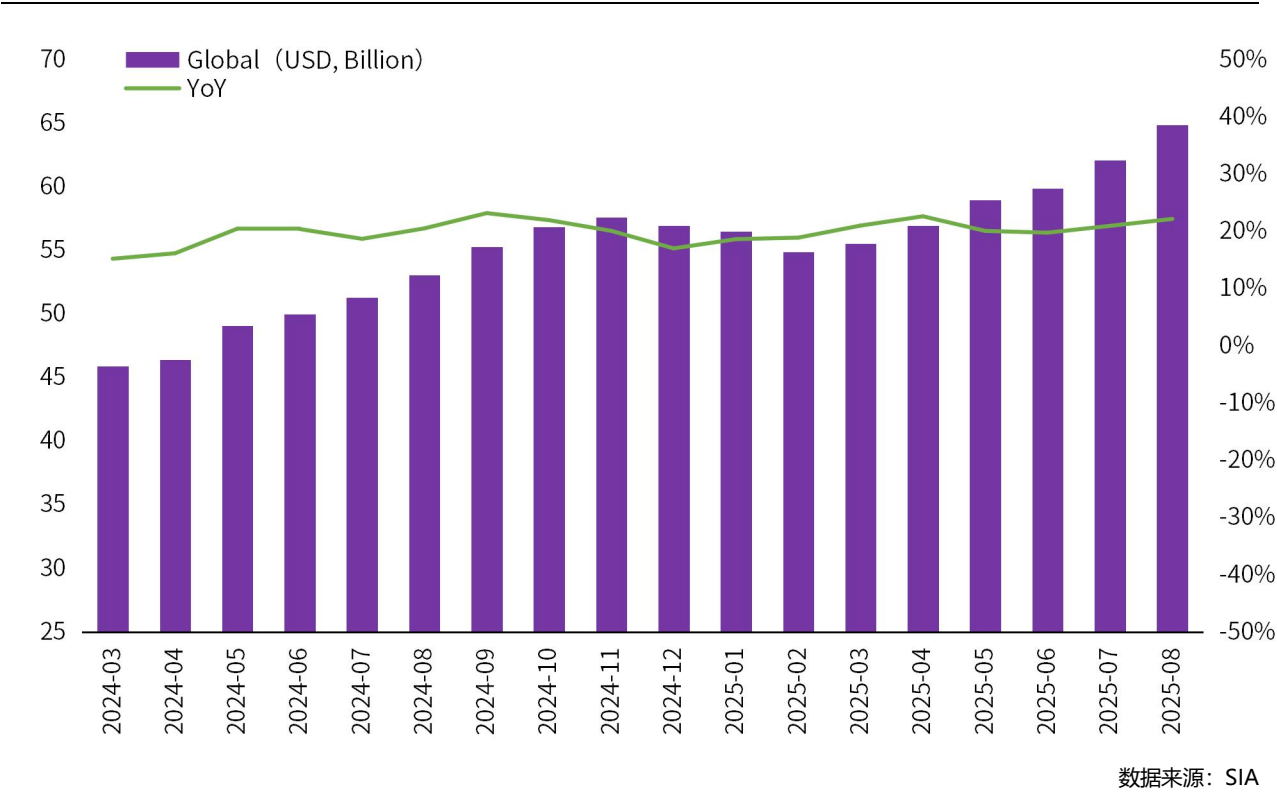
从区域表现来看，亚太及其他地区的销售额同比增长 43.1%，领跑全球市场；美洲市场销售额同比增长 25.5%，表现强劲；中国市场同比增长 12.4%，尽管增幅较为温和，但仍显示出增长潜力；欧洲市场则同比增长 4.4%，相对增长较缓慢；而日本市场则录得 6.9% 的同比下降，显示出该地区半导体市场的疲软表现。

在环比数据方面，亚太及其他地区销售额环比增长 6.9%，美洲市场增长 4.3%，中国市场增长 3.3%，而日本和欧洲市场的环比增长较为平稳，分别为 2.0% 和 1.0%。这些数据显示，尽管全球半导体市场在不同区域表现存在差异，但整体增长趋势保持强劲。

SIA 总裁兼首席执行官 John Neuffer 指出："全球半导体销售在 8 月份继续保持增长，远超去年同期水平。亚太地区和美洲市场的销售表现持续推动增长，其中存储芯片和逻辑芯片的销售增长尤为显著。"

总体而言，2025 年 8 月的半导体销售数据表明，全球市场尤其是在亚太和美洲地区的需求持续强劲，推动了整体销售的增长。尽管日本市场表现相对疲软，但随着人工智能、数据中心和高性能计算等领域的持续扩张，全球半导体市场预计将在下半年继续保持增长势头，区域间的差异仍需密切关注，特别是在全球贸易政策和地缘政治不确定性加剧的背景下。

全球半导体销售额（十亿美元）



● 美国十年期国债收益率：10 月呈震荡下行态势，月中一度跌破 4.0%关键关口

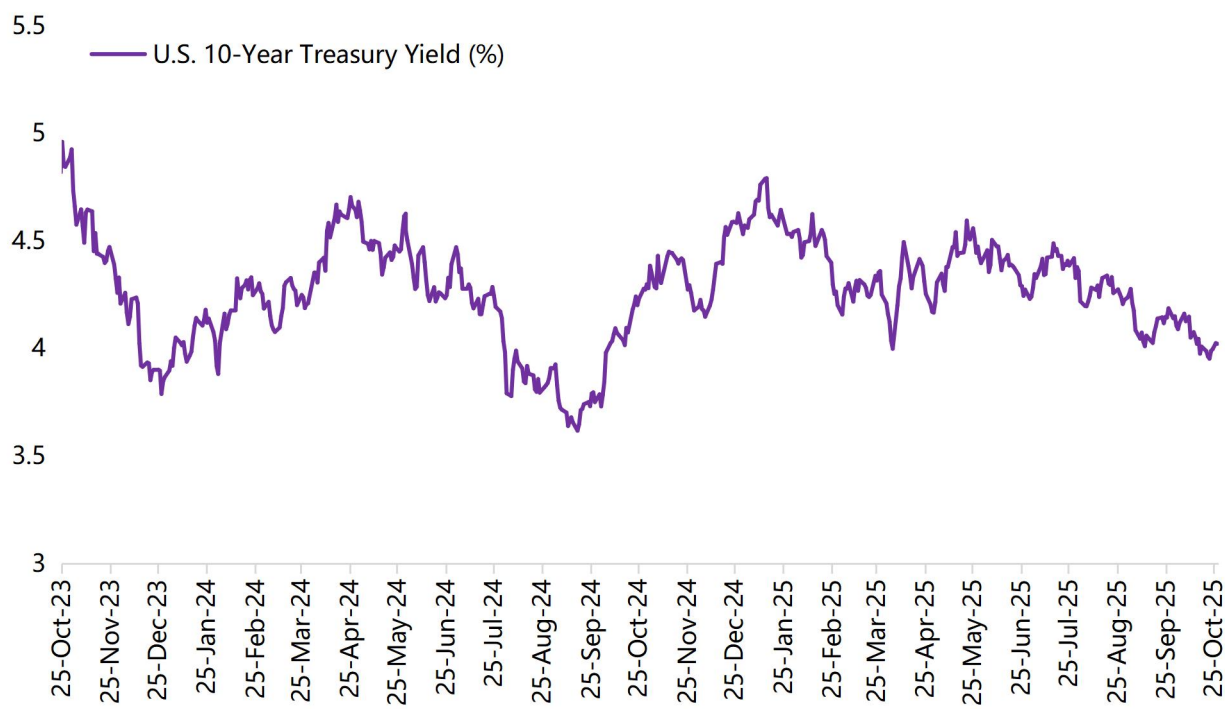
2025 年 10 月，美国 10 年期国债收益率整体呈现震荡下行走势，从月初的 4.10%水平逐步回落。收益率在 10 月 3 日录得 4.119%后开启下行通道，并于 10 月 16 日跌至月内低点 3.976%，为 7 月以来首次跌破 4.0%心理关口。尽管月末受中美贸易乐观情绪推动小幅反弹至 4.022%（10 月 27 日），全月仍累计下跌约 12 个基点，反映出市场对经济前景的担忧与货币政策宽松预期的升温。

10 月份影响利率走势的因素呈现多空交织态势：一方面，经济数据表现疲弱，9 月非农就业仅新增 12.8 万个岗位，失业率升至 4.4%，同时零售销售环比下降 0.8%，消费者信心指数回落，显示经济增长动能减弱；另一方面，通胀压力显现缓解迹象，9 月 CPI 同比上涨 2.6%，核心 CPI 降至 2.8%，连续三个月回落并创 2024 年 3 月以来新低，为美联储实施宽松政策提供了空间。在此背景下，美

联储政策预期发生显著转变,利率期货市场显示交易员对美联储在 10 月会议上降息 25 个基点的预期概率较高,并预计到 2026 年初还将有多次降息。值得注意的是,10 月下旬中美即将达成贸易协议的乐观情绪部分抵消了降息预期,促使月底美债收益率小幅回升。对于长期收益率前景,市场分析存在明显分歧,路透调查预估中值显示 10 年期收益率未来三个月将在 4.1%左右波动,而部分经济学家警告未来一至两年收益率可能因通胀再度升温而被推升至 6%或更高。

总体而言,10 月份美国 10 年期国债收益率的震荡下行,准确反映了经济数据转弱、通胀持续放缓背景下,市场对美联储货币政策转向宽松的强烈预期。未来收益率走势将主要取决于经济放缓程度、通胀回落的持续性以及中美贸易谈判的最终结果,投资者需重点关注 11 月初的 FOMC 会议声明及季度经济预测摘要 (SEP) 中对利率路径的最新指引。

美国 10 年期国债利率(%)



数据来源: Investing

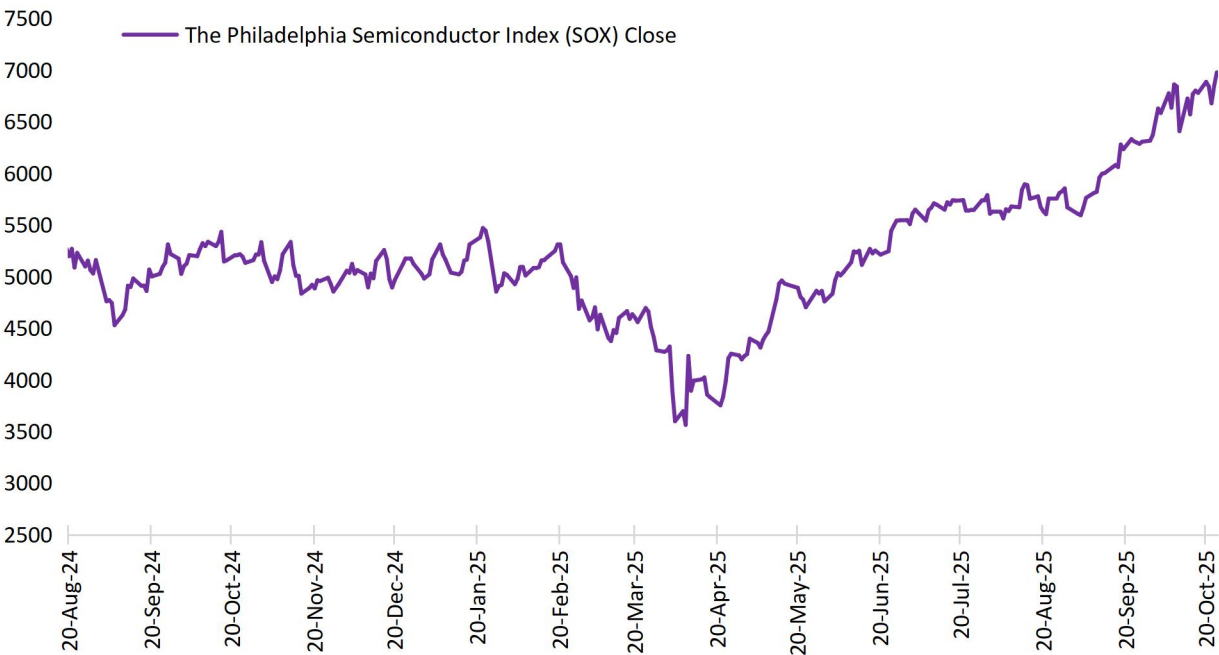
● 费城半导体指数 9-10 月走势分析：政策利好与业绩回暖驱动指数突破 6900 点

2025 年 9-10 月，费城半导体指数呈现稳健上行态势，从 9 月下旬的 6300 点附近震荡走高，至 10 月 24 日收报 6976.90 点，创下历史新高，期间累计涨幅超过 10.8%，显著跑赢大盘。这一轮上涨行情主要受益于多重利好因素的共同推动。10 月初指数突破 6500 点关键阻力位后连续走强，其中 10 月 8 日触及 6860.20 点阶段高位，这一突破主要受到美国商务部正式实施美马半导体合作协定带来的设备出口关税豁免、主要芯片企业三季度业绩普遍超预期，以及市场对美联储维持宽松货币政策预期的持续升温等因素的共同推动。

在政策环境与基本面改善的双重支撑下，半导体板块展现出强劲的上漲动能。一方面，美国政府对半导体产业的持续支持与相对宽松的货币环境为板块表现创造了有利条件；另一方面，行业基本面呈现积极变化，全球半导体销售额持续回升，供应链库存水平进一步优化，人工智能与汽车电子等新兴应用领域的需求保持强劲增长。尽管 10 月 10 日指数一度回落至 6407.60 点，出现技术性调整，但在企业财报超预期与行业前景向好的推动下，市场很快重拾升势，并于 10 月 13 日后连续多个交易日收涨，展现出较强的市场韧性。

总体而言，9-10 月费城半导体指数的强劲表现反映了全球半导体产业在政策支持、业绩回暖与技术创新多重利好驱动下的复苏态势。随着人工智能、汽车电子与工业数字化需求的持续释放，半导体板块有望在四季度继续保持相对强势，投资者可重点关注在 AI 算力、汽车半导体等细分领域具有核心竞争优势的龙头企业。

费城半导体指数(SOX)



数据来源：MacroMicro

二、半导体产业动态

半导体产业动态概览			
维度	厂商	经营动态	解读
短期影响	安世半导体 Nexperia	受国际贸易环境变化影响，其车规级基础芯片供应中断，导致日产、本田等多家车企面临停产压力，部分装配线可能在未来数日内停工	供应链中断引发行业危机：作为基础芯片领域关键供应商（市场份额约 40%），其供应波动直接冲击汽车制造业，凸显全球供应链脆弱性。
	英伟达 NVIDIA	股价于 10 月开盘上涨 3.2%，市值突破 5 万亿美元，成为全球首家达到此里程碑的上市公司	市值创历史纪录：市场对 AI 算力需求的极度乐观预期推动其估值达到前所未有高度，提振整个半导体板块士气。
	美光/三星/SK 海力士 Micron/Samsung/ SK Hynix	三星计划 Q4 将部分 DRAM 价格上调 15-30%，NAND 闪存价格上调 5-10%；美光因产能配置暂停报价；SK 海力士开始量产 321 层 QLC NAND 闪存	存储芯片进入涨价周期：原厂减产、转向 HBM 与 DDR5 导致传统 DRAM 与 NAND 供应紧张，价格短期全面上扬。
	三星 Samsung	Q3 营收 86.1 万亿韩元，环比增长 15.4%；营业利润 12.2 万亿韩元，同比增长 32%；内存业务季度销售额创历史新高	存储市场复苏带动业绩增长：HBM3E 和服务 器 SSD 需求强劲，推动半导体部门利润回 升，显示存储周期进入上行通道。
	美光 Micron	2025 财年 Q4 营收同比激增 46%至 113.15 亿美元，股价在财报后一个月 内上涨 22.7%，并开始对 192GB SOCAMM2 内存模块进行客户取样	业绩超预期强劲增长，彰显其在 AI 数据中心 存储市场的领先地位，新产品有望进一步巩 固其优势。
	恩智浦 NXP	Q3 营收 31.7 亿美元略超预期，车用芯 片业务环比增长 6%，并预计第四季度 营收中位数高于市场预期	汽车半导体市场出现复苏迹象，公司业绩改 善提振了市场对汽车电子领域短期需求的信 心。
	博通 Broadcom	发布新网络芯片 Thor Ultra，强化 AI 数据中心布局	博通通过推出 AI 互连芯片进一步抢占数据 中心基础设施市场。
	意法半导体 STMicroelectronics	Q3 营收 31.9 亿美元，同比微跌 2%； 第四季度展望略低于预期，调整 2025 年资本支出至约 20 亿美元	电动车需求放缓削弱汽车功率器件业务，但 影像传感器与 MCU 表现稳健，短期业绩受 消费电子与工业市场支撑。
	SK 海力士 SK hynix	Q3 营收 24.45 万亿韩元，营业利润 11.38 万亿韩元创历史新高，净利润同 比暴涨 119%；完成 2026 年 HBM 供 应谈判，HBM4 将于第四季度出货	业绩创纪录与供应锁定：HBM3E 和服务 器 DDR5 需求爆发推动利润创新高，提前完成 客户供应谈判确保短期业务可见性。

	兆易创新 GigaDevice	Q3 营收 26.81 亿元，同比增长 31.40%；净利润 5.08 亿元，同比增长 61.13%	受益存储行业景气回升：DRAM 行业供给格局改善形成“价量齐升”态势，短期业绩显著提升。
中期影响	英伟达 NVIDIA	在 GTC 大会上宣布与诺基亚推进 AI 原生 6G 平台、推出 NVQLink 量子计算技术，并与德国电信合作投资 10 亿欧元建设欧洲 AI 数据中心	构建全栈 AI 生态系统：通过 6G、量子计算和区域算力布局，拓展技术边界并深化全球市场渗透。
	亚德诺 ADI	与日月光签署备忘录，计划出售其马来西亚槟城封测工厂，并转向“Fab-Lite”模式	“轻封测化”成行业趋势：通过剥离重资产，模拟大厂旨在优化资本效率，聚焦核心技术，以应对多变的市场需求。
	英飞凌 Infineon	与罗姆签署合作备忘录，双方将在特定碳化硅功率器件封装上实现技术共享和互为第二供应商	合作提升供应链韧性：通过标准化封装和建立第二供应商体系，增强客户采购灵活性，应对地缘政治风险。
	微芯科技 Microchip	推出业界首款采用 3nm 制程的 PCIe Gen 6 交换器，支持 160 通道及后量子加密	破解 AI 算力瓶颈：新品提升数据中心内部互联效率，为中期 AI 集群规模扩张奠定基础。
	SK 海力士 SK hynix	在 OCP 2025 展会推出“AIN Family” AI-NAND 系列，面向 AI 存储应用	面向 AI 训练/推理的高带宽 NAND 产品策略成型，有望中期提升市场位置。
	中微半导体 Cmsemicon	Q3 营收 2.69 亿元，同比增长 21.88%；净利润 6581.85 万元，同比下降 3.66%	业务转型期的增长与挑战：营收增长显示市场回暖，但利润下滑反映产品结构调整与研发投入增加的中期压力。
长期影响	赛微电子 Silex	Q3 净利润因出售瑞典 Silex 微电子控股股权而激增 2199.1%，但扣非净利润亏损扩大至-2.35 亿元	战略转型阵痛：出售核心子公司获得短期巨额收益，但长期面临 MEMS 工艺能力削弱与主营业务可持续性的挑战。
	长鑫存储 CXMT	预计 2026 年初在上海科创板 IPO，估值或达 3000 亿元人民币	产 DRAM/存储化路线的资本化标志，对长期国产替代具有战略意义。
	日月光 ASE	在高雄投资建设先进封装新厂（K18B），目标 2028 年完工，以满足 AI/HPC 对 CoWoS 和芯片封装需求	布局先进封装产能：应对 AI 芯片长期封装需求，巩固其在后道制程的核心地位。
	国巨 Yageo	拟以 228 亿新台币全额收购芝浦电子，预计 2026 年 Q1 完成	通过并购扩展传感器业务，长期增强产品组合与全球市场影响力。
	Skyworks/Qorvo	官宣合并，估值 220 亿美元，预计 2027 年初完成，打造射频、模拟和混合信号半导体领域领导者	重塑射频芯片竞争格局：合并将催生射频芯片新巨头，通过整合互补技术增强在移动与国防、汽车等市场的长期竞争力。

（一）短期影响

● 安世半导体：供应链中断冲击全球汽车产业，多家车企面临停产压力

围绕安世半导体的国际贸易环境变化，在 2025 年 10 月对全球汽车产业造成了直接冲击。荷兰政府的监管干预与中国商务部的出口管制，影响了安世生产的车规级基础芯片的稳定供应。短期内，这一事件已引发供应链紧张：日产（Nissan）公开表示其芯片库存仅能维持至 11 月第一周；本田（Honda）因此暂停了墨西哥工厂的生产，并调整了美国和加拿大工厂的产量。欧洲汽车制造商协会警告，部分成员的装配线可能在未来数日内面临停工风险。

行业分析指出，安世半导体在基础芯片领域占据约 40% 的市场份额，其产品广泛用于汽车关键模块。尽管车企正积极寻找替代方案，但车规级芯片的认证周期长达数月，短期替代难度较大。梅赛德斯-奔驰首席执行官表示，此次危机需要通过协商寻求解决方案。此次事件凸显了全球供应链在复杂贸易环境下的脆弱性，使其成为半导体行业短期内亟待应对的挑战之一。

● 英伟达：市值突破 5 万亿美元里程碑，彰显 AI 算力龙头地位

英伟达股价在 2025 年 10 月开盘后上涨 3.2%，推动其市值突破 5 万亿美元历史大关，成为全球首家达到此里程碑的上市公司。短期来看，这一市值表现远超英国、法国等欧洲主要国家的股市总值，直接反映了资本市场对 AI 算力需求的极度乐观预期，并将显著提振整个半导体板块的投资情绪。中期而言，市值的飞跃为其通过股权融资、并购扩张提供了更强资本实力，有助于加速其在 6G、量子计算等新兴领域的布局。长期意义在于，5 万亿美元市值不仅体现了英伟达在 AI 训练和推理市场的垄断性地位，更标志着其已成功从芯片制造商转型为全栈 AI 基础设施供应商，这种商业模式的升华为其构建了难以逾越的竞争壁垒。

● 美光/三星/SK 海力士：存储芯片供需错配，价格进入上行周期

根据 TrendForce 报告，三星电子已发出第四季度提价通知，计划将部分 DRAM 价格上调 15% 至 30%，NAND 闪存价格上调 5% 至 10%。与此同时，美光则因价格与产能配置考量暂停报价。短期内，这一系列动作明确标志着存储市场进入全面涨价周期，将直接改善主要存储厂商的营收和利润率。中期来看，此轮涨价的根本原因在于结构性供需失衡：一方面，AI 推理应用催生了对大容量企业级 SSD 的强劲需求；另一方面，三星、美光、SK 海力士等原厂将更多产能转向利润更高的 HBM 和 DDR5 产品，并削减

或停止了 DDR4 等传统产品的生产，导致其供应紧张。长期而言，AI 服务器和数据中心对高性能存储的需求已成为新的增长引擎，Yole Group 预测 HBM 市场在 2030 年前将保持 33% 的年复合增长率，这将持续重塑存储厂商的长期产品战略和投资重点。

● 三星电子：存储市场复苏强劲，短期业绩显著改善

三星电子 2025 年第三季度财报显示，合并营收达到 86.1 万亿韩元，环比增长 15.4%，营业利润 12.2 万亿韩元，同比增长 32%。短期来看，这一强劲增长主要得益于设备解决方案（DS）部门的表现，其中内存业务季度销售额创下历史新高。HBM3E 高端产品和服务器固态硬盘的强劲需求是主要驱动力，表明 AI 服务器市场对高性能存储解决方案的需求持续旺盛。中期而言，存储市场的全面复苏将有助于三星进一步优化其产品结构，提高盈利能力，并在与美光、SK 海力士的竞争中巩固市场地位。长期意义在于，三星在 HBM 技术领域的领先地位及其在 AI 数据中心市场的深入布局，将为公司在未来的数字经济发展中占据有利位置提供坚实基础。

● 美光：AI 驱动存储需求，短期业绩与股价双丰收

美光在截至 2025 年 8 月 28 日的第四财季中，营收达到 113.15 亿美元，创下历史纪录，同比增长 46%。短期来看，这一强劲增长主要由 AI 数据中心对高性能存储解决方案（特别是 HBM）的爆炸性需求所驱动。公司毛利率显著提升，股价在财报发布后一个月内上涨 22.7%，远超大盘表现，这极大地提振了市场对存储行业的信心。与此同时，美光宣布开始对其新型 192GB SOCAMM2 内存模块进行客户取样，该产品在相同尺寸下提供了 50% 的容量提升和超过 20% 的能效改进。中期而言，此类高容量、低功耗产品的推出，是其巩固在 AI 数据中心市场地位的关键举措，旨在满足持续演进的 AI 基础设施需求。长期来看，美光在 HBM 等先进内存技术上的领先地位，以及其完成的 72 亿美元股票回购，均彰显了管理层对公司长期现金流和业务基本面的信心，为其在激烈的技术竞争中提供了持续投资的底气。

● 恩智浦：车用芯片需求初现回暖，Q3 财报略超市场预期

2025 年 10 月，恩智浦公布了 2025 年第三季度财报，营收为 31.7 亿美元，同比下降约 2.4%，但略高于市场预期的 31.6 亿美元。短期来看，公司车用事业群收入环比增长 6%，被市场视为汽车半导体需求回暖的积极信号，直接推动了其股价上涨。公司对于第四季度的营收指引中位数也略高于市场预期，进一步强化了短期乐观情绪。中期来看，恩智浦近期的收购活动，如收购车载网络公司 Aviva Links，表明其正积极强化在汽车

智能化和电气化核心领域的布局，以抓住行业复苏带来的增长机会。长期而言，汽车电子架构的持续演进以及工业物联网的稳步发展，将为恩智浦的长期产品路线图提供清晰的需求支撑。

- **博通：发布新网络芯片 Thor Ultra，强化 AI 数据中心布局**

博通在 2025 年 10 月宣布推出名为 “Thor Ultra” 的新一代网络芯片，专用于 AI 数据中心互连与大规模加速器芯片间通信。该芯片将扩大博通在 AI 基础设施中的角色，强化其与 NVIDIA Corporation 等厂商的竞争关系。短期来看，此举增强了博通在高景气的 AI 加速器 + 网络互连板块的话语权；中期则有望带来大规模数据中心客户订单，并推动其在 AI 计算系统配套生态中的地位提升。长期来看，若博通能够持续推动互连、交换及定制加速器的协同，则其可能成为未来 AI 系统关键基础件的「隐形冠军」。

- **意法半导体：公布 2025 年第三季度财报，汽车半导体需求持续低迷**

意法半导体 (STMicroelectronics) 于 2025 年 10 月 23 日公布了其第三季度财务业绩。报告显示，第三季度净营收为 31.9 亿美元，同比下降 2.0%；毛利率为 33.2%，较去年同期下降 460 个基点。净利润为 2.37 亿美元，同比下降 32.3%。

尽管公司预计第四季度营收将环比增长 2.9%，达到 32.8 亿美元，毛利率预计为 35.0%，但整体业绩仍受到汽车半导体需求疲软的影响。公司首席执行官 Jean-Marc Chery 表示，尽管个人电子产品和微控制器业务表现良好，但汽车和工业业务仍面临挑战。因此，公司已将 2025 年的资本支出计划下调至略低于 20 亿美元，以应对当前市场环境。

总体而言，STMicroelectronics 在短期内受益于个人电子产品和微控制器业务的增长，但汽车半导体市场的持续低迷可能对其整体业绩构成压力。公司需密切关注汽车市场的复苏情况，以调整其业务策略。

- **SK 海力士：Q3 业绩创纪录增长，HBM 供应锁定确保短期领先地位**

SK 海力士 2025 年第三季度财报显示业绩表现极为强劲，营收达 24.45 万亿韩元，营业利润 11.38 万亿韩元创下历史纪录，净利润同比暴涨 119% 至 12.60 万亿韩元，营业利润率提升至 47%。短期来看，这一卓越表现主要得益于 AI 服务器对 HBM3E 和大容量 DDR5 产品的爆炸性需求，其中 128GB 以上大容量 DDR5 出货量较上一季度增长一倍以上。同时，公司宣布已与主要客户完成 2026 年 HBM 供应谈判，新一代 HBM4 将于第四季度开始出货，这一进展确保了公司在未来数个季度的产能利用率和营收可见性。公司现金及现金等价物增至 27.9 万亿韩元，成功实现净现金头寸，为短期内的产

能扩张和技术升级提供了充分的财务灵活性。SK 海力士凭借在 AI 存储市场的率先布局，已在短期内建立起显著的竞争优势。

- **兆易创新：存储行业景气回升，短期业绩大幅增长**

兆易创新 2025 年第三季度实现营收 26.81 亿元，同比增长 31.40%，净利润 5.08 亿元，同比增长 61.13%。短期来看，这一显著增长主要受益于 DRAM 行业供给格局的持续改善，形成了“价量齐升”的良好市场态势。全球存储市场的周期性回暖以及公司在利基存储市场的精准定位，共同推动了业绩的快速提升。中期影响方面，随着存储价格企稳回升和需求持续增长，兆易创新有望凭借其产品组合优势和客户关系，进一步扩大市场份额。长期而言，公司在存储芯片领域的持续投入和技术积累，结合国产替代的大趋势，将为其在日益竞争的存储市场中建立可持续的竞争优势。

(二) 中期影响

- **英伟达：全栈 AI 战略协同推进，中期构建完整技术生态系统**

在 2025 年 10 月于华盛顿举行的 GTC 大会上，英伟达 CEO 黄仁勋系统性地公布了公司的全栈 AI 战略，重点涵盖 6G 通信、量子计算和区域算力基础设施三大领域。中期影响方面，英伟达宣布与诺基亚合作推进 AI 原生 6G 网络平台，推出融合 AI 超算和量子计算的 NVQLink 技术（已获 17 家量子计算公司支持），同时与德国电信（Deutsche Telekom）合作投资 10 亿欧元在德国慕尼黑建设 AI 数据中心，部署约 1 万个 GPU。这些举措形成了强大的战略协同效应：6G 布局瞄准下一代通信标准，量子计算卡位前沿科研领域，而欧洲数据中心建设则直接响应区域算力需求。短期来看，这一系列 announcement 进一步强化了资本市场对英伟达增长前景的信心，推动其市值突破 5 万亿美元大关。长期而言，英伟达正从单一的 GPU 硬件供应商，系统性地转型为覆盖通信、计算和基础设施的全栈 AI 解决方案提供商，这种生态系统的构建将为其在全球数字经济发展中创造持久的竞争优势和增长动力。

- **亚德诺：“轻封测化”战略转型，优化中期资本配置**

亚德诺与日月光签署谅解备忘录，计划出售其位于马来西亚槟城的封测工厂。与此同时，英飞凌在去年也采取了类似行动，出售其封测厂给日月光。这一系列动向标志着一场以“轻封测化”为特征的战略转型正在模拟和功率半导体巨头间蔓延。中期来看，此举并非简单的“去制造化”，而是一种战略性的取舍。通过剥离高资本投入、回报率相对较低的

后段封测资产，ADI 和英飞凌等公司能够显著降低资本开支占营收的比例（如 ADI 从 10%降至约 6%），将宝贵的现金流更多地投入到核心工艺研发、前段晶圆制造（如 12 英寸、SiC）等更具附加值的环节。这不仅优化了公司的资本结构，也使其能够更灵活地应对市场波动。长期而言，这种模式有助于 IDM 厂商在保持技术话语权和供应链安全的同时，实现“资本轻化”与“利润稳定”的平衡。

- **英飞凌：SiC 封装合作，构建中期供应链韧性**

英飞凌与罗姆于 2025 年 9 月联合宣布，双方已签署谅解备忘录，旨在建立碳化硅功率器件封装合作机制。根据合作内容，双方将在特定的顶部散热封装上实现技术共享，并互为第二供应商。中期影响在于，这一合作将极大增强 SiC 功率器件供应链的弹性。对于汽车、工业、AI 数据中心等高端应用的客户而言，他们可以从两家技术领先的公司采购封装兼容的产品，这显著降低了因单一供应商出现问题而导致的供应链中断风险，也简化了设计验证流程。长期意义上，封装标准化和供应商多元化将加速碳化硅技术在可再生能源、电动汽车等广阔市场的普及，同时也为双方在更广泛的功率半导体技术领域深化合作奠定了基础。

- **微芯科技：首发 3nm PCIe 6.0 交换机，破解 AI 数据中心互联瓶颈**

微芯科技于 2025 年 10 月宣布推出业界首款采用 3 纳米制程的 Switchtec™ Gen 6 PCIe® 交换器。短期来看，这款产品为正在构建下一代 AI 服务器的厂商提供了关键的互联解决方案，有助于缓解 GPU 与 CPU 之间因数据量激增而出现的带宽瓶颈。中期意义在于，它将单通道带宽从 PCIe 5.0 的 32 GT/s 提升至 64 GT/s，并支持最多 160 个通道。这种翻倍的带宽和极高的端口密度，对于中期 AI 集群规模持续扩大、计算单元数量激增的趋势至关重要，能有效减少处理器因等待数据而出现的闲置，提升整个计算系统的效率。长期来看，该产品集成的后量子加密等安全功能，也响应了未来数据中心对硬件级安全性的长期要求，为微芯在 AI 基础设施领域建立了重要的技术壁垒。

- **SK 海力士：推出 “AIN Family” 面向 AI 存储产品**

SK 海力士于 2025 年 10 月在 OCP 2025 峰会上披露其 “AIN Family” 高性能 NAND 存储解决方案，此系列包括针对 AI 推理/训练场景的高带宽 (B)、高密度 (D)、高性能 (P) 模块。短期影响在于其向 AI 专用存储市场发力，可在 AI 训练/边缘算力场景中获得先机；中期影响则为其可能扩大存储产品在云端数据中心的渗透，并提升议价能力与利润率；长期来看，若 SK 海力士成功推动高阶 NAND 技术（如 HBF / 堆栈架构）商

业化，则有望在 AI 时代存储高阶赛道中抢占领先地位。风险包括技术落地周期、成本控制、以及存储市场整体周期波动。

- **中微半导体：营收增长但利润承压，中期转型面临挑战**

中微半导体 2025 年第三季度营收 2.69 亿元，同比增长 21.88%，显示半导体市场整体回暖；然而净利润 6581.85 万元，同比下降 3.66%。短期来看，营收增长表明公司受益于行业复苏周期，产品市场接受度提升。中期而言，净利润下滑反映了公司正处于业务转型与产品迭代的关键阶段，研发投入增加、新产品推广费用上升以及市场竞争加剧等因素共同压缩了利润空间。公司需要在这一时期有效平衡短期盈利能力与长期发展投入，实现从传统产品向高附加值产品的平稳过渡。长期展望，如果公司能够成功完成产品结构调整并在细分市场建立技术优势，当前的增长困境可能为未来的可持续发展奠定基础。

(三) 长期影响

- **赛微电子：出售 Silex 控股权实现短期盈利，长期发展面临挑战**

赛微电子于 2025 年 10 月 27 日发布的三季度报告显示，公司通过出售瑞典子公司 Silex 微电子的控股权，实现净利润 15.76 亿元，同比激增 2199.1%。短期来看，这笔交易为公司带来了巨额的非经常性收益，显著改善了当期财务报表，并为公司提供了充足的现金储备。然而，从长期战略角度审视，此次出售实质上是“舍车保帅”的无奈之举：Silex 作为赛微电子旗下核心的 MEMS 工艺开发与制造平台，其控权的出让意味着公司长期积累的高端 MEMS 制造能力被削弱。同时，公司扣除非经常性损益后的净利润持续亏损且幅度扩大至 -2.35 亿元，暴露出其主营业务盈利能力不足的根本问题。长期而言，在失去 Silex 的技术支撑后，赛微电子如何重塑其核心竞争力和确保业务的可持续增长，将成为一个严峻的战略挑战。

- **长鑫存储：拟 2026 年科创板 IPO，估值战略意义重大**

长鑫存储计划于 2026 年在科创板上市，目标估值约 3000 亿元人民币，募资 200 亿至 400 亿元人民币。若成功上市，将为其技术研发和产能扩张提供资金支持，推动中国在 DRAM 和 HBM 等存储技术领域的自主可控。长期来看，长鑫存储的 IPO 将标志着国产存储替代路径的重要里程碑，有望减少对国际存储厂商的依赖，提升国内存储产业的国际竞争力。然而，技术差距和量产进度仍需密切关注，成功的关键在于其能否突破技

术壁垒并迅速扩大市场份额。

- **日月光：巨资投入先进封装，应对 AI 芯片长期需求**

全球封测龙头日月光宣布在中国高雄园区投资建设 K18B 先进封装新厂，重点部署 CoWoS 和芯片封装产能，预计 2028 年完工。短期来看，这一投资计划反映了当前 AI 加速器对先进封装需求的迫切性，日月光是此轮需求的主要受益者之一。中期而言，新工厂将有助于缓解全球 CoWoS 等先进封装产能的紧张状况，为包括台积电在内的整个产业提供补充。长期影响在于，随着摩尔定律放缓，Chiplet 与异质集成成为提升芯片性能的主流路径，先进封装的技术和产能将变得与前道制程同等重要。日月光此次大规模投资，是其巩固在后道产业核心地位、把握 AI 与 HPC 所带来的长期增长机遇的战略性举措。

- **国巨电子：收购芝浦电子，完善高端元件长期布局**

国巨电子于 2025 年 10 月宣布拟以 228 亿新台币全额收购芝浦电子（Shibaura Electronics），预计交易将于 2026 年第一季度完成。从长期战略角度来看，此次收购是国巨继成功整合基美（KEMET）与普思（Pulse）后，在高端元件领域的又一重要战略举措。通过将芝浦电子的温度传感器、电流传感器等核心产品纳入旗下，国巨将进一步丰富其高端元件产品组合，特别是在汽车电子和工业控制等高增长领域形成更完整的产品矩阵。长期而言，这一收购将使国巨从传统的被动元件供应商，加速转型为具备传感器、被动元件、模块化解决方案的综合元件供应商，显著增强其在全球电子元件市场的整体竞争力。随着电动汽车、工业自动化等产业对高端传感器需求的持续增长，此次并购将为国巨在未来市场竞争中占据更有利位置奠定坚实基础，实现其长期可持续发展的战略目标。

- **Skyworks & Qorvo：巨头合并重塑射频芯片市场长期格局**

美国射频芯片巨头 Skyworks 与 Qorvo 于 2025 年 10 月 28 日官宣合并，交易估值达 220 亿美元，预计将于 2027 年初完成。从长期战略角度来看，此次合并并非应对短期市场波动的举措，而是旨在重塑全球射频前端芯片市场的竞争格局。合并后的新公司将整合双方互补的技术专利（超 12,000 项专利）和产品组合，形成在智能手机、国防与航空航天、汽车电子等多元市场的全面覆盖。长期而言，这一合并将催生一个年营收约 77 亿美元的行业新巨头，通过显著的成本协同效应（预计年度节省 5 亿美元）和增强的研发实力，不仅能够更好地应对主要客户自研芯片带来的挑战，更将强化美国在射频

半导体这一关键环节的供应链控制力和全球话语权。然而，这一交易最终完成仍需通过全球主要市场监管机构的严格反垄断审查。

三、终端市场动态

终端市场动态概览			
类别	版块	厂商	9-10 月市场动态
人工智能	AI 芯片	OpenAI&博通 Broadcom	OpenAI 与博通合作定制 AI 芯片
		英伟达 Nvidia	英伟达 AI 芯片 Blackwell (GPU) 现已在美国全面投入生产
	云计算与大数据	高通 Qualcomm	高通发布两款数据中心级人工智能推理芯片
		英特尔 Intel	英特尔推出新一代数据中心 GPU
新能源	光伏/储能	宁德时代 CATL	宁德时代正推进钠新乘用车动力电池开发
	新能源汽车	比亚迪 BYD	比亚迪马来西亚工厂将于 2026 年投产
消费电子	智能手机	荣耀 HONOR	荣耀发布旗舰新品 Magic8 系列
		vivo	vivo 上海发布 X300 系列旗舰智能手机
	机器人	阿里云 & 英伟达 Alibaba Cloud &Nvidia	阿里云与英伟达官宣合作 Physical AI, 押宝具身智能、辅助驾驶
工业电子	工业自动化与控制	施耐德 Schneider	施耐德携手宏于推 Okken 授权配电盘，驱动电力基础设施升级
		罗克韦尔 Rockwell	罗克韦尔发布 FactoryTalk Design Workbench 免费设计软件
汽车电子	汽车产业链	安世 Nexperia	受安世供应影响，汽车制造商四处搜寻芯片
		英伟达 Nvidia	英伟达发布集软硬件一体化的 Hyperion 10 自动驾驶平台

通信 电子	通信网络	中兴 ZTE	中兴通讯蝉联中国云终端市场第一
		英伟达 Nvidia	英伟达宣布斥资 10 亿美元入股芬兰电信设备商诺基亚
医疗 电子	医疗设备	联影医疗 UNITED IMAGING	联影医疗与印度 Super health 签署 20 亿放射影像设备采购合同

(一) 人工智能

● OpenAI 与博通合作定制 AI 芯片

10 月 13 日，AI 龙头与博通发布公告称，两家公司将合作开发 10 吉瓦规模的定制 AI 芯片和网络系统机架。受此消息影响，博通股价周一开盘后拉涨近 10%，市值劲增超 1500 亿美元。OpenAI 将主导芯片和系统的设计，而博通则负责联合开发和部署。计划于 2026 年下半年开始部署，预计在 2029 年底前完成全部部署。

● 英伟达 AI 芯片 Blackwell (GPU) 现已在美国全面投入生产

10 月 18 日，黄仁勋表示英伟达最快的 AI 芯片 Blackwell 图形处理单元(GPU)现已在亚利桑那州全面投入生产，GPU 的需求依然旺盛，过去四个季度 Blackwell GPU 的出货量已达 600 万台。预计 Blackwell 芯片与明年推出的 Rubin 芯片合共的销售额将达到 5,000 亿美元。

● 高通发布两款数据中心级人工智能推理芯片

10 月 28 日 – 高通公司发布两款数据中心级人工智能推理芯片 AI200 和 AI250，配套推出整机架加速方案。新芯片采用神经处理单元(NPU)架构，单卡支持高达 768GB 低功耗内存，侧重 AI 模型推理而非训练，号称以更低总体成本提供行业领先性能。行业意义：高通进军数据中心 AI 芯片领域，挑战英伟达地位，AI 推理芯片市场竞争进一步加剧。受消息提振，高通股价单日涨逾 11%。

● 英特尔推出新一代数据中心 GPU

10 月 14 日 OCP 全球峰会上，英特尔正式发布了其新一代数据中心 GPU，代号为“Crescent Island”。该产品专为满足日益增长的人工智能推理工作负载而设计，搭载了英特尔的 Xe3P 微架构，并配备了高达 160GB 的 LPDDR5X 内存。此款 GPU 的推出

标志着英特尔在数据中心 GPU 领域的又一次重要进展。

（二）新能源

● 宁德时代正推进钠新乘用车动力电池开发

10月26日，宁德时代(386.940, 1.17, 0.30%)在日前的投资者关系活动记录表中，公布了钠电池未来的潜在应用场景及公司钠电产品进展。据透露，钠电池的低温性能、碳足迹、安全性能均更具优势，可以广泛应用于乘用车、商用动力等领域。公司发布的钠新电池已通过新国标认证，成为全球首款通过新国标认证的钠离子电池。钠新乘用车动力电池正在与客户推进开发、落地中，进展顺利。

● 比亚迪马来西亚工厂将于 2026 年投产

10月13日，比亚迪在接受机构调研时表示，马来西亚当地建设组装工厂（CKD），预计将于2026年正式投产。马来西亚组装工厂的建设开启了比亚迪在马来西亚发展的新篇章。比亚迪表示，公司承诺不仅体现在持续交付创新产品，更在于对马来西亚从本地组装到人才培养，再到电动出行的推广的电动生态的全面投入。

（三）消费电子

● 荣耀发布旗舰新品 Magic8 系列

10月15日，荣耀发布多款荣耀全场景新品。其中的重磅产品是荣耀旗舰新品荣耀 Magic8 系列，该款新机被正式定义“自进化 AI 原生手机”。值得注意的是，该新品采用了汇顶科技的多款创新方案。同时，荣耀还发布了一系列其他新品，包括荣耀 MagicPad3 Pro、荣耀 MagicPad3 12.5、荣耀手表 5 Pro、荣耀 Earbuds 4、荣耀亲选 KUMI AI Note 等。

● vivo 上海发布 X300 系列旗舰智能手机

10月13日，vivo 在上海发布 X300 系列旗舰智能手机。其中 X300 标准版主打小屏影像旗舰，全球首发联发科天玑 9500 芯片和 2 亿像素超高像素主摄，X300 Pro 版则在影像、防抖和性能上全面升级。该系列作为 vivo 品牌成立 30 周年的里程碑之作，在摄影算法、芯片定制调校等方面有多项创新。

● 阿里云与英伟达官宣合作 Physical AI，押宝具身智能、辅助驾驶

近日，阿里云和英伟达在 Physical AI（物理 AI）领域达成合作。阿里云人工智能平台 PAI 将集成英伟达 Physical AI 软件栈，将为企业用户提供数据预处理、仿真数据生成、模型训练评估、机器人强化学习、仿真测试等全链路平台服务，进一步缩短具身智能、辅助驾驶等应用的开发周期。资料显示，Physical AI（物理人工智能）是人工智能技术向物理世界延伸的分支领域，旨在通过融合多模态感知、空间关系理解和物理规则认知，实现与现实世界的交互。

（四）工业电子

- **施耐德携手宏于推 Okken 授权配电盘，驱动电力基础设施升级**

施耐德电机 Schneider Electric 宣布与台湾配电盘设备公司宏于电机携手合作，正式推出符合 IEC 61439 国际标准的「Okken 授权配电盘」。此次合作具备最高安全标准、提升维运效率、降低营运成本三大优势，充分展现国际技术与在地制造的成果，实时回应台湾高科技产业对电力系统安全与高可靠运行的迫切需求。

- **罗克韦尔自动化公司发布 FactoryTalk Design Workbench 免费设计软件**

10 月 28 日，罗克韦尔自动化公司发布 FactoryTalk Design Workbench 免费设计软件，用于构建微型控制系统。该软件支持 Micro800 系列可编程控制器，提供统一编程、配置和调试环境，简化小型独立自动化系统的开发流程。新工具具有与罗克韦尔 Logix 平台一致的界面，上手快，提升下载调试效率，并支持同时管理多台控制器设备。

（五）汽车电子

- **受安世供应影响，汽车制造商四处搜寻芯片**

10 月 29 日（路透社）——由于与荷兰公司 Nexperia 相关的半导体供应危机日益加剧，全球汽车制造商正争相寻找芯片，并向供应商确认库存是否充足，这威胁到整个行业的汽车生产。由于荷兰政府接管了芯片制造商 Nexperia，并禁止其产品从中国出口。此举是出于对 Nexperia 技术可能被转移至其中国母公司闻泰科技的担忧，美国已将闻泰科技列为潜在的国家安全风险。

- **英伟达发布集软硬件一体化的 Hyperion 10 自动驾驶平台**

10 月 28 日，英伟达发布集软硬件一体化的 Hyperion 10 自动驾驶平台，率先实现从车载 AI 芯片到自动驾驶大模型的全栈解决方案[16]。该平台采用双颗 Thor 车规超

级芯片 (INT8 算力合计约 2000 TOPS) 构成, 支持座舱娱乐与高级驾驶功能融合计算。

(六) 通信电子

● 中兴通讯蝉联中国云终端市场第一

近日, 国际数据公司 IDC 发布了《2025H1 中国云终端市场跟踪报告》, 中兴通讯以 44.5% 的市场占有率, 蝉联中国云终端市场冠军, 连续两年稳居榜首, 在云终端总体市场出货量、VDI 解决方案云终端、商用云终端市场出货量均位列第一, 并在消费类云终端市场持续大幅领先。

● 英伟达宣布斥资 10 亿美元入股芬兰电信设备商诺基亚

10 月 28 日, 英伟达公司宣布斥资 10 亿美元入股芬兰电信设备商诺基亚, 双方达成战略合作开发 AI 驱动的 6G 通信网络[。诺基亚将利用英伟达的 GPU 和 AI 技术构建智能化的移动网络解决方案, 打造以人工智能为核心的下一代 5G/6G 基站和无线接入设备。受此消息影响, 诺基亚股价单日飙涨 20%。

(七) 医疗电子

● 联影医疗与印度 Super health 签署 20 亿放射影像设备采购合同

联影医疗与印度医院网络 Super health 达成价值超过 250 亿卢比 (约合人民币 20 亿元) 的协议, 将由联影医疗为其即将建成的 100 家 Super health 医院提供、安装并负责全生命周期管理一整套先进的放射科系统, 助力医生提供卓越的医疗服务。联影医疗截至 2025 年上半年, 实现海外收入同比增长 22.48% 至 11.42 亿元, 收入占比达到 18.99%。此次合作, 不仅创下印度放射影像设备采购史上的规模之最, 更标志着中国高端医疗装备在全球市场实现了从产品输出到生态共建的关键跨越。

四、重点产品行情

(一) 存储芯片

2025 年 10 月存储芯片重点产品行情一览

产品	代表型号	价格趋势	交期（周）	供需状态
DDR4	8GB	上涨	2-3 周	平衡
DDR5	16GB	上涨	3-6 周	紧张
NAND Flash	128GB	上涨	3-6 周	紧张
eMMC	32GB	上涨	2-3 周	平衡
HBM	HBM3E	上涨	6-8 周	紧张
SSD	120GB	上涨	6-8 周	平衡

数据来源：TrendForce, CFM, Fusion

● 现货 NAND、DRAM 资源全面供应趋紧，存储价格集体强势上涨

1) 产品动态

- **DDR4、DDR5：** 由于数据中心对网络设备的需求持续强劲，旧款内存（如 DDR4）的寿命得以延长，加上市场可能低估了 DDR4 在数据中心交换器中的重要性，这预计将进一步推高平均销售价格（ASP）。尽管 DDR5 是新一代标准，但目前大多数网络交换机（包括 NVIDIA Spectrum 和 NVlink）仍在使用 DDR4。
- **NAND Flash：**企供应链瓶颈加剧，NAND Flash 产能受排挤，价格全面上涨 5-10%。
- **eMMC：** 原厂制程升级冲击产出，enterprise SSD 需求排挤效应显现，卖方掌握议价主导，eMMC 涨势强于 UFS。
- **HBM3E：** 价格上涨主要受到高端服务器、AI 和 GPU 市场需求的推动。

- **SSD:** 基于成本持续走高且资源仍处于控货阶段, PC 终端加快 design in 基于 QLC NAND 的 SSD 方案, 甚至近期个别 PC 客户释放 QLC SSD 大额订单。不过, 涨价之际, 存储厂商仍严格把控出货节奏。因此, 行业 SSD 市场行情以缩量上涨为主。

2) 市场趋势

- **消费端 DRAM 短缺严重:** 二季度以来, 原厂 DDR4 供应急剧收缩, 多数应用市场的 DDR4 资源基本处于停供状态, 而选择将更多的产能转移至 DDR5、HBM 等先进 DRAM 产品, 与此同时, 由于服务器市场既能消化庞大产能又具备更高利润空间, 成为原厂优先保障供应的对象。那么相应的, 消费市场 DRAM 供应难以得到有效满足。因此, 实际上消费端 DRAM 资源面临的供应结构性短缺更加严峻。
- **存储应用端全面涨价:** 在原厂供应干预下, 现货贸易端包括 NAND 和 DRAM 在内的所有资源价格快速上涨。在上游资源日益走高且供应收紧的影响下, 相对应的产品生产升本大幅走高, 服务器、手机、PC 等各应用端的存储成品全面掀起涨价潮。而部分手机低端机型甚至采用降容方案以此缓解成本压力。
- **存储厂商严控出货:** 存储品牌厂商普遍放慢接单节奏, 市场成交以小批量订单为主。目前供应端的态度仍然是影响整个存储市场的主要因素, 若未来资源端仍持续处于趋紧状态, 供需天平加速向卖方倾斜, 存储厂商控货惜售的情绪将更加强烈, 那么后续存储成品端的价格也将延续上涨趋势。

3) 厂商动态

- **美光:** 宣布推出 192GB SOCAMM2 客户样品, 以促进低功耗内存在人工智能数据中心的更广泛应用。SOCAMM2 扩展了美光科技首款 LPDRAM SOCAMM 的功能, 在相同的紧凑尺寸下提供 50% 的容量提升。增加的容量可将实时推理工作负载的首次令牌时间 (TTFT) 显著缩短 80% 以上。
- **威刚:** 产品线全部面临缺货, 进入 10 月开始惜售。据台媒报道, 因存储产业掀起前所未见的缺货潮, 存储模组厂威刚董事长陈立白直呼, 这次从来没有过的经验, 威刚产品线包括 DDR4、DDR5、NAND Flash 首度全都面临缺货, 虽然手上还有新台币百亿元的库存, 但进入 10 月之后只能踩煞车惜售。

(二) GPU

2025 年 10 月 GPU 重点产品行情一览

产品	代表型号	厂商	价格趋势	交期 (周)	供需状态
消费级	GeForce RTX 5090	英伟达 (NVIDIA)	上涨	3-16 周	紧缺
	GeForce RTX 4090	英伟达 (NVIDIA)	上涨	3-5 周	紧缺
	Radeon RX 7900 XTX	超威半导体 (AMD)	下降	2-3 周	平衡
数据中心	A100 Tensor Core	英伟达 (NVIDIA)	上涨	4-6 周	紧缺
	H100 Tensor Core	英伟达 (NVIDIA)	上涨	6-8 周	紧缺
	Instinct MI350	超威半导体 (AMD)	上涨	3-4 周	紧缺

数据来源：Fusion，证券时报网，Digi-Key，财报狗

● AI 需求致高端 GPU 货源紧缺，价格进一步上涨

1) 市场动态

- **头部厂商合作加强:** 为了应对持续增加的市场需求, NVIDIA、AMD 和 Intel 等 GPU 厂商加速与台积电 (TSMC) 和三星等代工厂的合作, 推动 7nm 及以下工艺节点的扩产。尤其是 NVIDIA 和 AMD, 它们与代工厂的合作密切, 计划在 2025 年下半年增加约 10-15%的生产能力。
- **原材料和核心组件的短缺:** 显存 (尤其是 GDDR7 和 HBM3) 的供应紧张加剧, 导致 GPU 生产延误。这些高性能显存芯片的生产工艺要求极高, 且生产能力有限, 导致 NVIDIA H100 和 AMD Instinct 等高端产品的供应面临瓶颈。由于显存短缺, GDDR7 和 HBM3 的价格上涨了 5%-8%, 进一步推高了整体 GPU 的价格。

2) 市场趋势

- **数据中心致需求持续高涨：**下 NVIDIA 的下一代架构（如 Blackwell 系列）产品已开始上市，这可能对 H100、A100 等上一代产品的供需和价格产生影响。同时，高端数据中心 GPU 的需求持续高涨。
- **持续的供应挑战：**英特尔在财报会议中透露，其 10/7 纳米成熟制程节点出现供应紧张，且这一问题可能持续至 2026 年。这从侧面反映了整个行业对算力芯片，包括 GPU 及其配套元件的需求仍然非常强劲，供应端依然承压。
- **竞争格局的新变化：**NVIDIA 与英特尔从竞争走向部分领域的合作，标志着 AI 生态系统的复杂化。同时，AMD 通过获得政府级大单，展示了其在顶级高性能计算市场与 NVIDIA 抗衡的强大实力。

(三) CPU

2025 年 10 月 CPU 重点产品行情一览

类别	产品	品牌	价格趋势	供需状态
消费级	i5-14400/F	英特尔 (Intel)	上涨	平衡
	i5-14600KF	英特尔 (Intel)	上涨	平衡
	i7-14700K/KF	英特尔 (Intel)	上涨	紧张
	Ultra 7 265K/KF	英特尔 (Intel)	下降	平衡
服务器	至强系列	英特尔 (Intel)	上涨	紧张
	EPYC 系列	超威半导体 (AMD)	下降	平衡

数据来源：中关村在线，太平洋电脑网，深铭易购，超能网，eBay

- **AI 成为绝对主导，驱动全产业链需求**

➤ **消费电子：**

1. 旧款英特尔 CPU 量价齐升：第 12 至 14 代酷睿中端型号（如 i5 系列）是涨价主力。这背后是旺盛的市场需求与英特尔成熟制程（Intel 7/10）产能不足的共同作用。同时，新一代酷睿 Ultra 200 系列因性能未达预期、定价偏高，市场接受度较低，导致旧款型号需求持续高企。
2. AMD 消费级 CPU 相对平稳：10 月份，AMD 的 AM5 接口处理器价格整体保持平稳，部分型号甚至有小幅下跌，散片和拆机片的优惠力度更大。

➤ **服务器：**英特尔服务器 CPU 供应紧张，供需失衡的核心原因是数据中心和 AI 应用需求激增，以及英特尔将有限产能优先分配给利润更高的服务器市场。此外，基板等外围元件的短缺也加剧了供应挑战。

1) 市场趋势

- **需求端：**AI PC 生态加速形成，英特尔和 AMD 都在大力推动其新一代内置 NPU（神经网络处理单元）的 CPU（如酷睿 Ultra 系列）。尽管目前市场接受度有波动，但这表明本地化 AI 运算（边缘计算）已成为下一个必争之地，预示着未来消费级硬件都将为 AI 应用优化。
- **供应端：**英特尔用于生产多数至强处理器和 13/14 代酷睿的 Intel 7 和 10 纳米成熟制程节点已达到满负荷运转，面临产能瓶颈。为优先保障利润更高的服务器市场供应，英特尔已将产能向数据中心产品倾斜。这种供需失衡预计会持续到 2026 年第一季度。
- **“AI 就绪”成为刚需：**数据中心运营商为了高效运行大语言模型等 AI 工作负载，正在紧急升级其基础设施。这不仅催生了对 NVIDIA H100/Blackwell 等专用 AI GPU 的巨额需求，也同步拉动了与之配套的高性能服务器 CPU（如英特尔至强、AMD EPYC）的需求。因为强大的 CPU 是管理和喂数据给 AI GPU 的必要条件。
- **“成熟制程”的再定义：**英特尔面临的 Intel 7 和 Intel 10 纳米节点的产能紧张，直接影响其主力产品（12-14 代酷睿和部分至强 CPU）的供应。这表明，在追求最先进工艺的同时，市场上庞大存量需求所依赖的“成熟”或“主流”制程，其产能分配同样至关重要。

信息来源

- [1] Analog Devices, Inc. "ADI Signs Agreement with ASE to Divest Penang Test & Assembly Facility." Analog.com Press Release, October 2025.
- [2] ASE Group. "ASE Begins Construction of K18B Advanced Packaging Facility in Kaohsiung." ASEGlobal.com Press Release, October 2025.
- [3] Broadcom Inc. "Broadcom Introduces Thor Ultra Chip to Accelerate AI Data Center Connectivity." Broadcom Newsroom, October 2025.
- [4] Business Insider. "How Nvidia could end up worth \$6 trillion after reclaiming its spot as ..." 2025.
- [5] European Commission. "Recommendation on outbound investments (2025/63)," 2025.
- [6] Government of the Netherlands. "Statement on Intervention in Nexperia Citing the Goods Availability Act," October 12, 2025.
- [7] GigaDevice. "Third Quarter 2025 Financial Report." October 2025.
- [8] Infineon Technologies AG. "Infineon and ROHM Announce SiC Packaging Collaboration to Strengthen Supply Chain Resilience." Infineon.com Newsroom, September 2025.
- [9] Japanese Government. "Cabinet Decision on the Revision of the Information Processing Promotion Act and the Special Account Act," 2025.
- [10] Micron Technology, Inc. "Micron Reports Record Fourth Quarter Fiscal 2025 Results." Investors.Micron.com, September 2025.
- [11] Microchip Technology Inc. "Microchip Launches Industry's First 3nm Switchtec™ Gen 6 PCIe® Switch." Microchip.com Newsroom, October 2025.
- [12] Ministry of Commerce of the People's Republic of China (MOFCOM). "Announcements No. 61 and 62 on Expanding the Export Control of Rare Earths and Related Technologies," October 9, 2025.
- [13] Ministry of Trade, Industry and Energy (MOTIE), South Korea. "Semiconductor Industry Support Measures in Response to Potential U.S. Tariffs," 2025.
- [14] Micron Technology. "Fourth Quarter FY2025 Financial Results." September 2025.

[15] NVIDIA Corporation. "NVIDIA and Deutsche Telekom to Build € 1 Billion AI Data Center in Munich." Newsroom.NVIDIA.com, October 2025.

[16] National Development and Reform Commission (NDRC) and Ministry of Finance of China. "Notice on the Formulation of the 2025 List of Integrated Circuit Enterprises or Projects, Software Enterprises Eligible for Preferential Tax Policies (Fagai Gaoji [2025] No. 385)," 2025.

[17] NXP Semiconductors N.V. "NXP Reports Third Quarter 2025 Results." NXP Official Investor Relations, October 2025.

[18] NVIDIA Corporation. "NVIDIA and Deutsche Telekom to Build € 1 Billion AI Data Center in Munich." NVIDIA Newsroom, October 2025.

[19] Reuters. "China's ChangXin Memory Technologies Plans \$42 Billion IPO on Shanghai STAR Market in 2026." Reuters Technology News, October 2025.

[20] Reuters. "Nvidia storms past \$5 trillion valuation as AI boom powers meteoric rise." 29 Oct 2025.

[21] S&P Global & J.P. Morgan. "Global Manufacturing PMI," September 2025.

[22] SEMI. "SEMI Urges EU to Quadruple Chip Act Budget, Drives Signature of Semicon Declaration," September 29, 2025.

[23] Semiconductor Industry Association (SIA). "Global Semiconductor Sales Increase 21.7% Year-to-Year in August," October 3, 2025.

[24] SK hynix Inc. "SK hynix Unveils AIN Family High-Performance NAND Storage Solutions at OCP Global Summit 2025." SKHynix.com Press Release, October 2025.

[25] STMicroelectronics. "STMicroelectronics Reports Third Quarter 2025 Financial Results." ST.com Investor Relations, October 23, 2025.

[26] Skyworks Solutions / Qorvo Inc. "Skyworks and Qorvo to Combine to Create \$22 Billion U.S.-Based Leader in High-Performance RF, Analog and Mixed-Signal Solutions." SkyworksIR.com / Qorvo.com, October 28 2025.

[27] Samsung Electronics. "Third Quarter 2025 Earnings Report." October 2025.

[28] The Government of the Republic of Korea. "Fiscal Investment Plan for Global Semiconductor Competitiveness Enhancement," April 15, 2025.

[29] TrendForce. "Samsung and SK hynix Plan Q4 DRAM and NAND Price Hikes amid Tight Supply." TrendForce Report, October 2025.

[30] U.K. Government. "Announcement on Sanctions Against 11 Chinese Entities," October 15, 2025.

[31] U.S. Congress. "Chip Security Act (Proposed)," 2025.

[32] U.S. Department of Commerce, Bureau of Industry and Security (BIS). "Department of Commerce Announces Recission of Biden-Era Artificial Intelligence Diffusion Rule, Strengthens Chip-Related Export Controls," 2025.

[33] Wall Street Journal. "U.S. Weighs Requiring 1-to-1 Ratio for Domestic Chip Production vs. Imports," September 2025.

[34] World Semiconductor Trade Statistics (WSTS). "Global Semiconductor Sales Data," 2025.

[35] Yageo Corporation. "Yageo Announces Acquisition of Shibaura Electronics for NT\$22.8 Billion." Yageo.com Investor Relations, October 2025.

[36] 赛微电子股份有限公司. "三季度净利润同比激增 2199% 核心系瑞典 Silex 控股权出售." Sina Finance, 27 Oct 2025.

[37] 全球半导体观察, "英特尔推出新一代数据中心 GPU "Crescent Island" , 2025.10.15

[38] 证券时报网, "OpenAI 与博通联手开发定制 AI 芯片, 博通股价飙升近 10%", 2025.10.14

[39] 新浪财经, "比亚迪: 马来西亚工厂将于 2026 年投产" , 2025.10.13

[40] 新浪财经, "宁德时代: 公司钠新乘用车动力电池正在与客户推进开发、落地中" , 2025.10.26

[41] 国际电子商情, "荣耀旗舰新品 Magic8 系列采用多款汇顶创新方案" , 2025.10.15

[42] CIO Taiwan, "施耐德携手宏于推 Okken 授權配電盤 驅動電力基礎設施升級" , 2025.10.23

[43] 汽车之家, "一口价 28.99 万起 磁浮底盘/新增白色内饰 新款凯迪拉克 CT6 上市" , 2025.10.22

- [44] 中兴官网, “中兴通讯蝉联中国云终端市场第一”, 2025.10.15
- [45] 动脉网, “20 亿, 联影医疗签 “最大规模” 采购合同”, 2025.10.23
- [46] EET-China, “从 100 多疯涨到 500 多! 到底谁在买 DDR4 内存? 为啥不买 DDR5? ”, 2025.10.27
- [47] CFM 闪存市场, “现货 NAND、DRAM 资源全面供应趋紧, 本周存储价格集体强势上涨! ”, 2025.10.14
- [48] CFM 闪存市场, “行业 SSD 价格再度上调但涨幅收敛, 整体交易缩量上涨! ”, 2025.10.21
- [49] CFM 闪存市场, “威刚:产品线全部面临缺货,进入10月开始惜售”,2025.10.17
- [50] CFM 闪存市场, “涨价效应持续发酵, 行业、渠道 SSD 及内存条、嵌入式 NAND 成品再度上调价格”, 2025.10.28
- [51] CFM 闪存市场, “SK 海力士:Q3 创下季度历史最高业绩,Q4 开始供应 HBM4, 明年正式扩大销售”, 2025.10.29
- [52] CFM 闪存市场, “美光 192GB SOCAMM2 宣布送样: 采用 1 γ 制程技术, 能效提升 20%”, 2025.10.23
- [53] 证券时报网, “英伟达 RTX 4090 显卡全网断货, 库存几近被扫光, 最高涨至 5 万元”, 2025.10.19
- [54] 阿思达克财经, “英伟达(NVDA.US)称 Blackwell 晶片已在亚利桑那州全面投产”, 2025.10.29
- [55] CTIMES, “AMD 与美国能源部合作建构新世代超级电脑”, 2025.10.28
- [56] 财报狗, “英特爾發表新一代 AI 筆電晶片 "Panther Lake", 首度採用 18A 製程”, 2025.10.12
- [57] 财报狗, “英特爾 10 / 7 製程供應吃緊 短期無擴產計劃”, 2025.10.28
- [58] 财报狗, “超微、甲骨文深化 AI 合作 將打造全球首個搭載 MI450 GPU 公有雲超級運算叢集”, 2025.10.22
- [59] 中关村在线, “酷睿 13/14 代处理器价格普涨, 日本市场涨幅达 10%-20%”, 2025.10.12
- [60] 太平洋电脑网, “英特尔上调海外旧款酷睿 i3/i5/i7/i9 处理器价格, 最高涨幅达 15%”, 2025.10.17
- [61] 腾讯网, “【2025 年 10 月】10 月装机走向与推荐 (市场分析部分/总第 114 期) ”, 2025.10.01

[62] 深铭易购, “英特尔多代处理器全球提价, 部分涨 20%”, 2025.10.17

[63] 超能网, “Intel 10/7 节点芯片需求旺盛导致产能吃紧, 英特尔将把产能倾向服务器市场”, 2025.10.25

[64] EEPW, “需求超过供应 英特尔预警 Intel10 和 Intel7 节点 CPU 短缺”, 2025.10.28

[65] Reportify, “通富微电-2025 年三季度因客户需求强劲超预期”, 2025.10.28

[66] 曙后星孤网, “怪不得 CPU 疯狂涨价! Intel CFO: 需求异常强劲已供应紧张”, 2025.10.30

[67] Reuters, “Automakers hunt high and low for chips as supply crisis worsens” 2025.10.30

[68] 华尔街见闻, “英伟达超进化! 软硬件一把抓, 智能驾驶大变局”, 2025.10.28

[69] 英飞凌官网, “Silicon carbide power modules in new EasyPACK™ C package enhance efficiency and lifetime of industrial applications”, 2025.10.29

[70] vivo 官网, “巨出片 出巨片, vivo X300 系列发布, 售价 4399 元起”, 2025.10.13

[71] 电子工程专辑, “高通发布 AI 芯片 AI200 和 AI250, 正式进军数据中心市场挑战英伟达”, 2025.10.28

[72] Reuters, “Nvidia deal casts AI haze over Nokia valuation ”, 2025.10.29

免责声明

安芯易电子商务（深圳）有限公司(下称“安芯易公司”)所发布的月度报告由安芯易公司市场部基于现已公开的资料、信息、研究报告等进行整理编制而成。

本报告所载的资料、意见及推测仅反映安芯易公司在报告发布当期的判断、观点，仅供学习参考之用，不构成对所述产品的出价、征价、要约或要约邀请，不构成任何合同或承诺的基础，不构成买卖任何投资工具或者达成任何交易的推荐，亦不构成任何投资、采购及其他应用建议和指导，对任何因直接或间接使用本报告涉及的信息和内容或者据此进行交易、投资所造成的一切后果或损失，安芯易公司不承担任何法律责任。因此，读者在阅读本报告时应保持警惕，并进行独立的判断和分析。

安芯易公司对本报告中所引用的资料、研究报告所涉及的或从第三方媒体获得的信息及数据的真实性、准确性、完整性和及时性不作任何明示或默示的保证。所发布的信息、观点以及数据有可能因发布日之后的情势或其他因素的变更而不再准确或失效，但安芯易公司不承担更新不准确或过时的信息、观点以及数据的义务，在对相关信息进行变更或更新时亦不会另行通知。

该报告版权归安芯易公司及相关内容提供方所有，未经授权，任何人不得以任何方式转载、修改、翻版、分发、复制、发表。

安芯易电子商务（深圳）有限公司

2025 年 10 月



安芯易隶属于Ample Solutions集团,成立于2008年,在全球拥有8个办公室,专注于为全球电子制造业客户提供元器件全球采购及供应链服务。我们始终秉持“专注、专业、坚韧、谦卑”的核心价值观,为客户提供卓越服务,助力客户成功。

我们拥有100+资深采购专家,并与来自全球的10000+供应商建立合作,致力于以更快的速度,更低的成本,为客户解决元器件供应链问题。

在深圳和香港,我们建立了两个高标准品质控制中心,严格遵循国际品质控制体系。从供应商管理到品质检测,全方位地防范风险,确保客户的元器件供应链安全和稳定。



洞察行情 精准决策

